



2020年4月1日

各 位

Circuit Foil Luxembourg への MicroThin™ ライセンス供与について

当社（社長：西田計治）は、Circuit Foil Luxembourg Sarl（社長：Fabienne Bozet、以下 Circuit Foil 社）とキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」が使用される微細回路プリント配線板プロセスである MSAP（Modified Semi Additive Process）に関する当社保有特許の非独占的ライセンス契約を締結したことをお知らせいたします。

この度、新たに Circuit Foil 社へライセンスを供与することにより、当社が保有する MSAP 工法に関する権利の認知度向上とこれに伴う当社キャリア付極薄銅箔の販売拡大が期待できると考えております。

【Circuit Foil Luxembourg sarl の概要】

所在地 6, Salzbaach, L-9559 Wiltz, Luxembourg

代表者 Fabienne Bozet

設立 1960 年

主要製品 電解銅箔

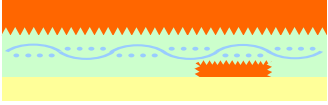
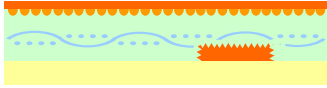
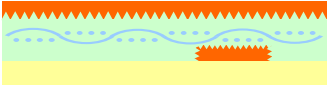
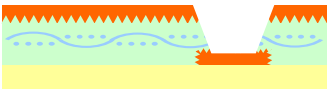

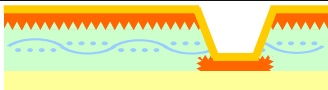

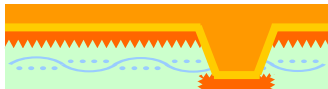







以上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL 03-5437-8028 Eメール PR@mitsui-kinzoku.com

■ 回路形成プロセス比較 –サブトラクティブ工法(汎用工法) vs MSAP工法–

工程	サブトラクティブ工法(汎用工法) Subtractive Method	MSAP工法 Modified Semi-Additive Process
ラミネート		
ハーフエッチング		
レーザー穴あけ		
化学銅めっき		
パターン形成	パネルめっき 	ドライフィルム 露光 / 現像 
	ドライフィルム 露光 / 現像 	パターンめっき 
	ハード エッチング 	ドライフィルム 剥離 
	ドライフィルム 剥離 	フラッシュ エッチング 

特徴

微細回路形成に不適

微細回路形成に適する

回路断面

